



华芯光织 实习纳新

青春启航 职向未来

华芯光织以光子织物算力背板为核心，依托自研硅光芯片与玻璃基中介层，构建强耦合算力域全光互联系统，显著提升算力密度，打造下一代 AI 算力核心基础设施。华芯光织面向在校学子的实习成长通道现已开启，我们期待与优秀学子并肩，深耕光算领域，解锁算力新机遇！

一、招聘岗位

1. PIC / 光芯片主设计工程师

岗位职责：

- 负责光芯片总体方案设计与关键模块架构规划；
- 负责光波导、无源器件、调制/探测器件相关方案设计与集成；
- 负责光芯片版图规划、关键指标分解及设计迭代；
- 负责与版图、工艺、封装、测试等团队协同推进设计落地；
- 负责流片前设计评审、问题分析及设计优化。

任职条件：

- 硕士及以上学历，光学、光电子、微电子、集成光学等相关专业；
- 具备硅光/光子芯片实习经验，有完整设计到流片实习经验者优先；
- 熟悉常见光器件原理与设计方法，如波导、耦合器、调制器、探测器等；
- 熟悉光子器件与光路设计流程，熟悉至少一种相关设计/仿真工具，如 Lumerical、COMSOL、OptiFDTD、INTERCONNECT、VPI 等；
- 有 PDK 使用、版图协同或流片实习经验者优先；



- 具备较强的系统理解能力和跨团队协作能力。

2. 电光 IO 器件工程师

岗位职责：

- 负责电光器件方案设计与性能指标定义；
- 负责调制器、探测器及相关器件的设计、仿真与优化；
- 负责器件与驱动、接收链路之间的接口协同；
- 参与器件测试方案制定、测试数据分析与设计改进；
- 参与新型器件方向的技术预研与技术积累。

招聘条件：

- 硕士及以上学历，光电子、微电子、电子工程、物理等相关专业；
- 具备电光器件设计或仿真经验，有调制器/探测器实习经验者优先；
- 熟悉器件物理、电光协同设计及相关仿真方法；
- 熟悉电光器件设计流程，熟悉至少一种相关仿真工具，如 Lumerical、COMSOL、Ansys、VPI 等；
- 具备较好的实验数据分析能力与问题定位能力；
- 具有较强的学习能力和工程推进能力。

3. 光子版图 / PDK 实现支持工程师

岗位职责：

- 负责光芯片版图实现、器件拼接与版图优化；
- 负责 PDK 单元调用、版图规则检查与版图交付支持；
- 负责流片前版图检查、设计规则收敛及问题整理；
- 协助完成测试结构版图设计与工程化实现；
- 支持设计团队完成版图相关流程和文档管理。

任职条件：



- 本科及以上学历，微电子、电子工程、光电子等相关专业；
- 具备版图设计实习经验，有光子版图、模拟版图或相关版图实习经验者优先；
- 熟悉版图设计流程及基本设计规则；
- 熟悉至少一种版图设计工具或平台，如 KLayout、Cadence、L-Edit 或相关光子版图平台；
- 熟悉 DRC / LVS 流程者优先；
- 具备较强的细节把控能力和工程执行能力；
- 有流片实习经验者优先。

4. 封装 / 2.5D / 板级协同工程师

岗位职责：

- 负责先进封装方案评估、系统排布规划与集成协同；
- 负责芯片、封装、板级之间的接口定义与协同推进；
- 负责封装相关设计输入整理，并与外部封装合作方对接；
- 负责热、机械、互连等相关问题的统筹分析；
- 支持系统级集成方案收敛与风险评估。

任职条件：

- 硕士及以上学历，微电子、封装、电子工程、材料等相关专业；
- 具备先进封装、SiP、2.5D/3D 集成实习经验者优先；
- 熟悉芯片、封装、板级协同设计流程；
- 熟悉相关封装/热/互连分析工具者优先，如 Allegro Package Designer、Ansys、Icepak、HFSS、SIwave 等；
- 具备系统集成意识和多团队协作能力；
- 具备较强的问题分析与推进能力。

5. 高速模拟前后端协同与测试工程师

岗位职责：

- 负责高速模拟链路方案评估与器件接口协同；



- 负责相关器件选型、性能评估与联调验证；
- 负责高速信号测试、参数调试及问题分析；
- 参与链路性能优化、测试方案制定和结果分析；
- 支持硬件系统集成与调试工作。

任职条件：

- 硕士及以上学历，电子工程、微电子、通信等相关专业；
- 具备高速模拟电路、接口电路或高速链路测试实习经验者优先；
- 熟悉常见高速测试方法和仪器使用，如示波器、BERT、VNA、频谱仪等；
- 熟悉至少一种相关仿真或分析工具者优先，如 ADS、HSPICE、Spectre、Matlab 等；
- 具备较强的问题定位和分析能力；
- 有相关芯片、模块或系统联调实习经验者优先。

6. 控制 / Firmware / Bring-up 工程师

岗位职责：

- 负责系统控制架构设计与底层控制方案实现；
- 负责设备初始化、配置、状态读取及调试流程开发；
- 负责底层控制代码、驱动程序及 bring-up 流程开发；
- 负责联调过程中问题定位与控制逻辑优化；
- 配合硬件、测试和软件团队推进系统集成。

任职条件：

- 本科及以上学历，电子、自动化、计算机、通信等相关专业；
- 具备 FPGA、MCU、嵌入式控制或底层驱动开发实习经验者优先；
- 熟悉常见控制接口和硬件调试流程；
- 熟悉至少一种相关开发环境或调试工具，如 Vivado、Quartus、Keil、STM32CubeIDE 等；



- 熟悉常见调试方式，如 JTAG、UART、SPI、I2C 等；
- 具备较强的系统调试能力和工程实现能力；
- 有复杂硬件系统实习经验者优先。

7. 软件 / Demo / 测试栈工程师

岗位职责：

- 负责测试软件、演示软件及相关工具链开发；
- 负责自动化测试脚本、数据采集、日志系统开发；
- 负责系统演示流程组织与软件支持；
- 负责结果展示、可视化与分析工具开发；
- 配合控制、硬件和测试团队完成系统联调。

任职条件：

- 本科及以上学历，计算机、软件工程、电子信息等相关专业；
- 具备 Python / C++ 开发实习经验者优先；
- 具备测试自动化、数据处理或系统联调实习经验者优先；
- 熟悉常见软件开发与数据分析流程，熟悉相关工具者优先，如 Python、Pandas、Matplotlib、PyQt、Flask 等；
- 具备良好的工程习惯和跨团队沟通能力；
- 有硬件控制软件、实验平台软件或演示系统实习经验者优先。

8. PCB / 电源 / 时钟 / 接口硬件工程师

岗位职责：

- 负责板级硬件方案设计与原理图开发；
- 负责电源、时钟、控制与外部接口相关硬件设计；
- 负责板级器件选型、接口规划与调试支持；
- 负责与封装、控制、测试等团队协同完成系统对接；
- 负责板级问题分析与设计优化。



任职条件:

- 本科及以上学历，电子工程、通信、自动化等相关专业；
- 具备高速板卡、复杂硬件系统或混合信号硬件设计实习经验者优先；
- 熟悉电源、时钟、接口电路及常见调试方法；
- 熟悉至少一种原理图/PCB 设计工具，如 Altium Designer、Cadence Allegro 等；
- 具备较强的原理图设计和工程实现能力；
- 有复杂系统板级开发实习经验者优先。

9. 测试验证工程师

岗位职责:

- 负责系统测试方案制定与验证计划管理；
- 负责器件、模块及系统级测试组织与实施；
- 负责测试数据分析、性能评估和问题闭环；
- 负责测试平台、测试流程和验收标准建设；
- 配合设计、封装、软件等团队推进问题定位和优化。

任职条件:

- 硕士及以上学历，电子、光电子、通信、物理等相关专业；
- 具备硬件系统测试、光电测试或高速链路测试实习经验者优先；
- 熟悉常见测试仪器和数据分析方法；
- 熟悉至少一种数据分析或测试工具者优先，如 Python、Matlab、LabVIEW 等；
- 具备较强的问题定位能力和系统验证意识；
- 有复杂系统联调和验收实习经验者优先。

二、福利待遇



- 丰厚薪资福利：博士 12K-16K、研究生 8K-12K、本科 6K-8K, 五险一金、午餐补贴、节日福利；
- 完善新人培养：导师一对一带教，系统化岗前培训，快速上手职场；
- 清晰职业赛道：专业 + 管理双线晋升，不埋没每一份才华；
- 年轻活力团队：扁平化管理、无内卷内耗、沟通高效、氛围轻松；
- 广阔发展平台：核心项目参与、行业资源对接。

三、联系人和联系方式

- 联系人：张经理/赵女士
- 联系方式：010-61287841/2
- 简历接收邮箱：huaxinguangzhi@126.com

四：公司地址

- 总部：北京市丰台区南三环中路赵公口甲 13 号
- 工业园区：北京市大兴区西红门镇金大路 13 号

以青春赴热爱，以初心赴前程，愿您就业无忧，职场有路，
华芯光织与您一同奔赴璀璨未来！